

2011年12月29日

報道関係者各位

## UMC、A+テクノロジーソリューションを提供、 8インチウエハ製造能力の更なる向上に注力

專業ファウンドリー業界で最も包括的な 0.11  $\mu\text{m}$  Al BEOL プラットフォーム

【台湾・新竹発】世界的リーディング半導体ファウンドリーのユナイテッド・マイクロエレクトロニクス・コーポレーション(以下UMC)は本日、ファウンドリー業界で唯一となる8インチウエハ工場向けのトータル 0.11  $\mu\text{m}$  Al BEOL(アルミ配線の半導体製造ライン工程)プロセスである A+テクノロジープラットフォームを提供することを発表しました。これにより、お客様は主流の 0.13  $\mu\text{m}$  と 0.11  $\mu\text{m}$  Cu BEOL(銅配線の半導体製造ライン工程)のほかに、コスト競争力のあるソリューションを選択することが可能となりました。このA+プラットフォームは、同業他社にないトータル技術の組み合わせを提供しており、logic/MM、RFCMOS、eFlash、eE<sup>2</sup>PROM、eHV や CIS などの技術を含み、製品のインテグレーション、性能及びコストなど、お客様からの多様なニーズに対応します。

UMCアジア営業及びコーポレートマーケティング VP の王國雍(Steve Wang)は、「多くのアプリケーションは、コストパフォーマンスを求めるために、依然として8インチウエハで製造しています。例えばタイミングコントローラー、LCD コントローラー、リモートコントローラー、小型パネルディスプレイドライバー、監視カメラや医療機器向け CMOS イメージセンサーなどには、今回発表のA+ソリューションが最適です。この包括的な技術ポートフォリオを有するA+ソリューションにより、0.18  $\mu\text{m}$  または 0.13/0.11  $\mu\text{m}$  Cu BEOL 製品の移行を考慮するお客様は、競争力を向上させるため、市場での差別化を図ることができます」とコメントしました。

当社独自の 0.11  $\mu\text{m}$  A+プラットフォームと最先端ソリューションを融合することによって、製品のコスト、性能、機能において最適なバランスで設計できるようになります。言い換えますと、A+は、8インチ最先端製造技術とアグレシブな Al BEOL 設計ルールとの組み合わせで、8インチウエハ製造において究極の技術ソリューションとなります。この包括的なA+ソリューションには、シリコン検証済みの IP、HV-LDMOS、I/O デバイス、RF モジュールと受動部品がすべて含まれているだけでなく、当社8インチウエハの柔軟性の高い製造能力を生かし、お客様のニーズに広く対応できるサポー

トを提供します。

###

### UMCについて

UMCは、世界的なリーディング半導体ファウンドリーとして、多彩なアプリケーション向けに最先端技術と製造サービスを提供しています。UMCのファウンドリーソリューションは、顧客志向型のサービスを重視しながら、得意とする先端プロセスの 65nm、45/40nm、ミックストシグナル／RFCMOSなど、幅広いスペシャルティテクノロジーを提供しています。製造拠点は、十ヶ所あり、先端の 300mmウエハ工場は台湾 (Fab 12A) とシンガポール (Fab 12i) にあります。この二工場は、既に多様な製品を量産しています。世界中で約 14,000 名の従業員を擁し、台湾、日本、シンガポール、ヨーロッパ、米国に営業拠点を設けています。UMCの詳細情報については、Webサイトをご覧ください。(<http://www.umc.com>)

### Note From UMC Concerning Forward-Looking Statements

Some of the statements in the foregoing announcement are forward looking within the meaning of the U.S. Federal Securities laws, including statements about future outsourcing, wafer capacity, technologies, business relationships and market conditions. Investors are cautioned that actual events and results could differ materially from these statements as a result of a variety of factors, including conditions in the overall semiconductor market and economy; acceptance and demand for products from UMC; and technological and development risks. Further information concerning these risks is included in UMC's filings with the U.S. SEC, including on Form F-1, F-3, F-6 and 20-F, each as amended.

###